A104

高圧条件における多孔性セラミック膜の CO2 透過および分離特性

(広大工)○(正)吉岡朋久*、(学)糸口 聡、(正)金指正言、(正)都留稔了

はじめに

分離膜を利用した CO₂の分離・回収プロセスは,低コ ストの環境対策技術として期待されているが¹⁾,近年で は、水性ガスシフト反応における H₂/CO₂, CO 分離や天 然ガスからの CO₂/CH₄ 分離など,室温から中温域で比較 的高圧力下での操作が必要となる CO₂ 分離技術の開発 が望まれている.支持体上に製膜された1 nm 以下の超 微細孔を有する多孔性無機膜は、機械的強度および耐熱 性に優れるため、高圧条件下でのガス分離膜として有望 と考えられ、本研究では、多孔性アモルファスシリカ薄 膜における CO₂の高圧下(~4 MPa)での CO₂透過機構 と CO₂/N₂および CO₂/CH₄ 分離特性について検討した.

1. 実験方法

多孔性シリカ膜をゾルーゲル法により作製し²⁾,上流側 0.2 MPa,下流側を大気開放として各種ガスの透過率を測 定することで膜のキャラクタリゼーションを行った.次に, 35 ℃から 200 ℃において上流圧力を 0.2~4.1 MPa の範 囲で変化させて CO₂の透過率を測定した.また,CO₂/CH₄ま たは CO₂/N₂混合ガス(9:1)の分離実験において,分離特性 の下流圧力依存性(0.1~4.1 MPa)について検討した.

2. 実験結果および考察

Fig. 1 に, 本研究で 用いたシリカ膜の 200 ℃ における各種ガス 透過率の分子径依存 性を示す.気体透過 率比は, H₂/C₃H₈:3700, CO₂/CH₄:16 であり, 高 い水素選択性を示し たが,大きさが 0.3 nm 以上の分子について も分子篩性を有し, 0.3 ~0.4 nm 程度の細孔 が存在していると考え られる. また, He や H₂ は活性化拡散, CO₂ は表面拡散, N, およ



びCH₄の透過率はKnudsenから活性化拡散的傾向を示し, ピンホールの少ない分離膜であった.

Fig. 2に異なる操作圧力における CO₂透過率の温度依存 性を示す.上流圧が 0.2 MPa の場合,透過率は表面拡散的 傾向を示したが,上流/下流圧が 4.1/3.6 MPa では極大値を 有した.この透過特性は, CO₂の Langmuire 的な吸着平衡 関係³⁾,およびガス相とは異なる拡散性とその細孔内密度 依存性を考慮した Eq. (1)により,膜との相互作用や膜構造 に起因する値をパラメータとして良好にフィッティング可能で あった.これらのパラメータを用いて CO₂透過率の圧力依存 性を推算すると, Fig. 3 に示すように実測値の傾向と良好に 一致した. CO₂ の臨界温度(31 °C)以上でバルク的な細孔 内凝縮が起こらない温度においても、1 MPa を超えるような 操作圧力下では、細孔内への吸着・充填の影響により、拡 散性がガス状態の透過からは偏寄することが示された.



供給ガス全圧 4.1 MPa のもとで, CO_2/CH_4 混合ガス ($CO_2:CH_4 = 9:1$)分離時の各成分透過率および CO_2/CH_4 透 過率比の下流 CO_2 分圧依存性を Fig. 4 に示す. 下流全圧 を 0.1 MPa から 3.6 MPa に増加させることにより, CO_2/CH_4 透過率比は, 35 °C で 2 倍, 100 °C においても 1.6 倍となり, いずれの温度においても下流操作圧力の増加に伴って分 離性の向上が認められた. 高圧下で操作することにより, 膜 細孔内に選択吸着成分である CO_2 が高濃度で存在し, CH_4 の透過を阻害したためと考えられる. CO_2 選択性は劣るもの の, CO_2/N_2 混合ガス系においても同様な傾向が見られた.

低濃度,常圧下では CO2選択性がさほど高くない多孔膜 においても,比較的高圧操作条件のもと CO2濃度が高い混 合ガスの分離を行う際には,効果的な CO2分離が可能では ないかと期待される.



引用文献

- 1) 平成 9,10 年度 NEDO 委託業務成果報告書, 二酸化炭 素高温分離・回収再利用技術研究開発.
- 2) 吉岡ら, 膜, 32, 45 (2007).
- 3) 糸口ら, 化学工学会第 74 年会, E 309, 横浜 (2009).

^{*}e-mail : tom@hiroshima-u.ac.jp, Tel : 082-424-7719